

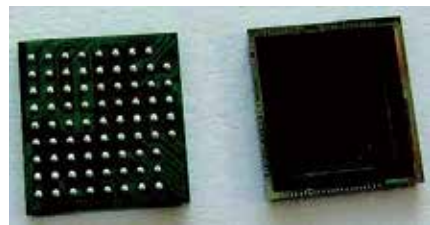


自動車・鉄道・船舶

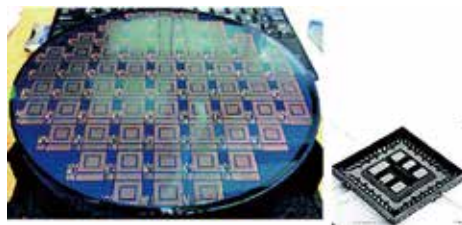
家電・エレクトロニクス

航空・宇宙・海洋

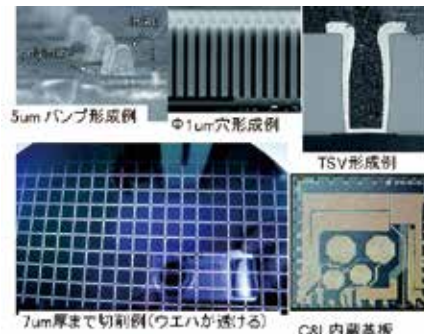
1 チップ～ウエハの貫通電極形成、MEMS・OE 系複合回路／構造設計・開発実装の一貫試作、少量生産受託



ZyCSP™ 実装 5M CIS



TSV TEG



ウエハ加工例

得意技術

- ・独自の TSV 技術を基に 3D 積層化実装構造の設計及び関連の超高密度加工試作製造技術
- ・ピアラスト TSV 技術と従来のフリップチップ実装やワイヤボンディング実装との融合技術
- ・CIS 用 WLCSP (ZyCSP™) 技術および特殊超小型カメラ実装・及び SiP 設計・試作

主要事業・主要製品

- ・半導体の 2.5D ~ 3D 実装、WLCSP 実装、TSV 回路 TEG の試作開発
- ・半導体 2.5D ~ 3D 実装用の関連材料、複合実装設備及び周辺テスト治具の開発と評価
- ・独自の TSV 技術を基にした半導体 2.5D ~ 3D 実装技術のライセンスと技術コンサルティング

得意な顧客・市場分野

家電・エレクトロニクス（半導体デバイス実装関連分野）

｜ グローバルビジネス ｜

2011 年末、米国半導体大手に TSV 技術の国際特許 4 ファミリーを技術移転

｜ 横浜市の認証制度 ｜

横浜知財みらい企業

｜ 公的助成事業 受託 ｜

研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP) 採択
戦略的基盤技術高度化支援事業 (サポイン) 採択
ものづくり補助金採択

今後の展開について

MEMS、医療用半導体デバイス

｜ 主要設備・研究体制 ｜

2011 年ふくおか ist の三次元半導体研究センター（糸島）開館時、構内に開発センター及び同 LSI 開発センター（百道浜）内に 3 次元積層・複合実装 SiP 回路設計センターを開設。社員が技術者で、汎用実装から超高密度実装までの融合実装技術開発をベースに R&D 連携ビジネスを推進。

｜ 主要取引先 ｜

電子機器・デバイスメーカー、大学等の関連研究開発機関

｜ 取引先金融機関 ｜

横浜銀行、三井住友銀行

名称	カブシキガイシャザイキューブ 株式会社ザイキューブ	代表者	益子原 學	担当窓口	長見 晃	資本金	3,400 万円	従業員数	6 名
所在地	〒226-8510 横浜市緑区長津田町4259-3 東工大横浜ベンチャープラザ(YVP)			TEL	045-350-3101	FAX	045-350-3102		
HP	http://www.zy-cube.com			E-mail	info@zy-cube.com				